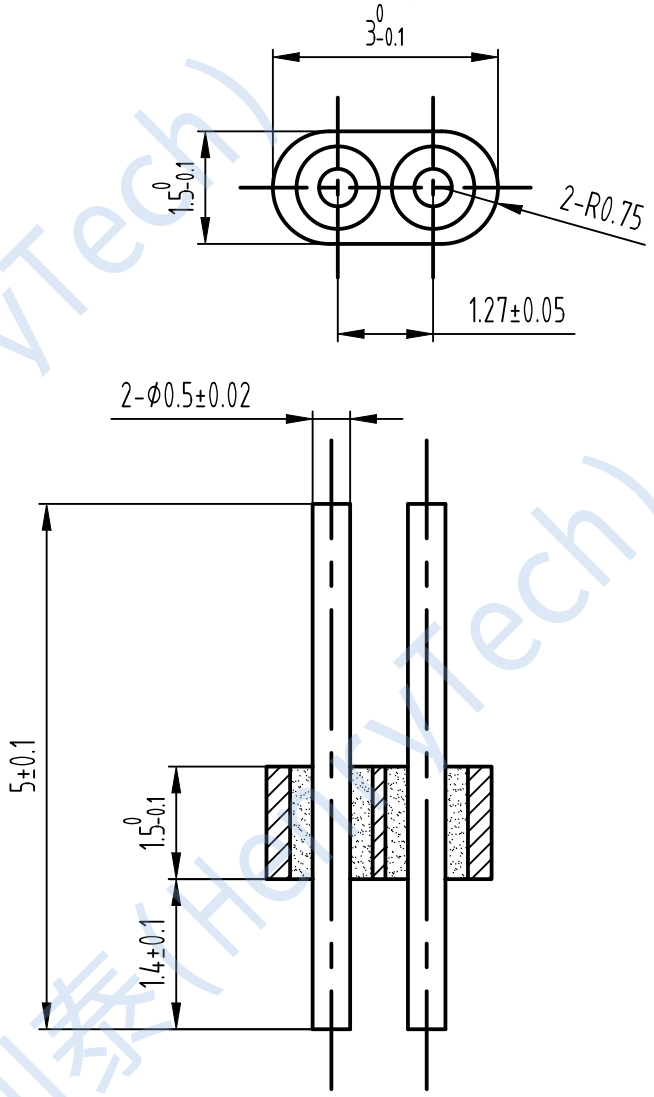


**技术要求：**

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10$^{-3}$Pa · cm$^{3}$ /S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥0.5μm软金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借通用件登记 | | | | | | | |
| 描 图 | | | | | | | |
| 校 描 | | | | | | | |
| 旧底图总号 | | | | | | | |
| 签 字 | | | | | | | |
| 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | | |
| | 设计 | M. | 标准化 | | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| | 审核 | | | | | | 10:1 |
| | 工艺 | | 日期 | | 共 页 | 第 页 | |

装配图

HN-LP2-0.5-1.27(5-1.4)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰(HenryTech)